

TIF700Q是一种填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

特性

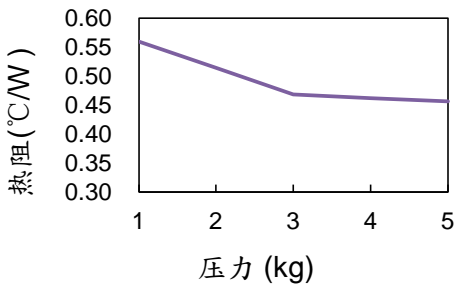
- 》良好的热传导率: 8.0 W/mK
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性, 柔软兼有弹性, 适合于低压力应用环境

应用

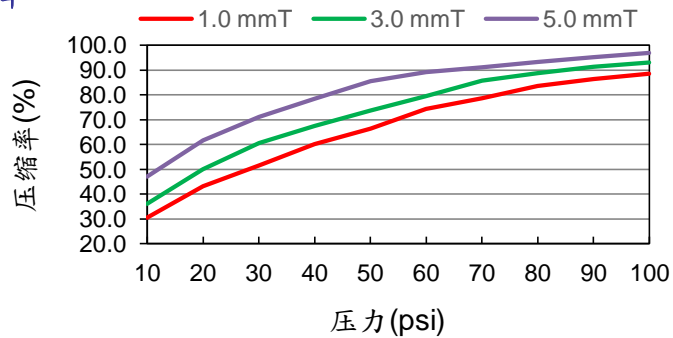
- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》充电桩
- 》LED电视、灯具

TIF700Q系列特性表		
颜色	灰色	Hoar
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****
厚度范围	1.0mm--10.mm	ASTM D374
硬度	60 Shore 00	ASTM D2240
比重	3.48 g/cc	ASTM D297
使用温度范围	-40~160°C	*****
击穿电压(T= 1mm 以上)	5.5 KV	ASTM D149
介电常数@1MHz	4.5 MHz	ASTM D150
体积电阻率	5.2X10 ¹³ Ohm-meter	ASTM D257
热传导率	8.0 W/mK	ASTM D5470
	8.0 W/mK	GB-T32064
总质量损失 (TML)	0.30%	ASTM E595
防火等级	UL94 V0	UL E331100

热阻 @ kg



压缩率



产品规格

标准厚度:

0.040"(1.0mm)-0.400" (10.0mm)

标准尺寸:

10"×16" (254mm×406mm)

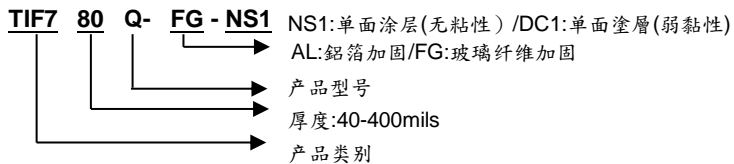
TIF系列可模切成不同形状提供。

如需不同厚度请与本公司联系。

欲了解更多导热材料的产品信息

请与本公司联系。

产品型号说明



导热材料

发热材料

导热工程塑料

发泡硅胶

模切制品

加拿大:

Tel: +001-604-2998559

E-mail: sales@thermazig.com

中国:

Tel: +86-769-38801208

E-mail: jor@ziitek.com

台湾:

Tel: +886-2-22771007

E-mail: frances@ziitek.com.tw

导热介面材料
应用技术下载

